

半導體先進封裝設備及矽光子應用技術論壇

• 時間：2024/6/27（禮拜四）9:00

• 地點：國立中興大學機械工程學系130系友講堂

聯絡方式：陳專員 lisa2003831@dragon.nchu.edu.tw (04)22840433 ext. 416
王副理 yumin@dragon.nchu.edu.tw (04)22840433 ext. 416



時間	主題	主講人
主持人：國立中興大學機械系 邱顯俊教授		
09:00~09:30	報到	
09:30~09:35	貴賓介紹與致詞	與會貴賓
09:35~09:40	頒發感謝獎牌與大合照	
09:40~10:20	半導體先進封裝設備產業現況及發展趨勢 Industry overview and Development Trends of the Advanced Packaging Equipment Industry in Semiconductors	金工中心 陳怡樺產業分析師
10:20~10:40	Tea break	
10:40~11:20	因應先進封裝的半導體製程設備思維與挑戰 Mindset and Challenges of Advanced Packaging in Semiconductor Manufacturing Equipment	優貝克科技 ULVAC 吳東嶸副總經理
11:20~12:00	Wet Process and TBDB for Heterogeneous Integration	辛耘企業 鍾佩翰協理
12:00~13:00	Lunch	
主持人：美商科磊 葉錫勳處長		
13:00~13:40	半導體熱製程設備解決方案 Semiconductor Thermal Process Equipment Solutions	志聖工業 蔡朝仁經理
13:40~14:20	從 AI 看台灣光傳輸的挑戰與機會 Challenges and Opportunities in Taiwan's Optical Transmission from the Perspective of AI	工研院電光所 溫新助經理
14:20~15:00	新世代高速矽光子光學引擎之研究 Road to the Next-Generation of High-Speed for 3.2Tbps Si-Photonics Optical Engine	國立中興大學電機系 劉浚年教授
15:00~15:20	Tea break	
主持人：國立中興大學工學院 蔡志成副院長		
15:20~16:00	矽光子在封裝領域的機會與挑戰	萬潤科技 蔡俊宏協理
16:00~16:40	矽光子的未來市場機會與測試和組裝的挑戰	日商駿河 資深產品行銷經理游智閔
16:40~16:45	Wrap-up and closing remarks	國立中興大學工學院 蔡志成教授兼副院長

主辦單位 國立中興大學、國立中興大學智慧機械技術研發中心、國立中興大學先進智慧製造技術聯盟

協辦單位 台灣電子製造設備工業同業公會

贊助單位 美商科磊、辛耘企業、志聖工業、熱力應用、永喬科技、凱勒斯科技、由田新技、創控科技、優貝克科技